

2014-2020年中国印制电路板(PCB)行业监测与投资战略咨询报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2014-2020年中国印制电路板(PCB)行业监测与投资战略咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201408/110723.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接提供者。根据电路层数可分为单面板、双面板和多层板。常见的多层板一般为4层板或6层板，复杂的多层板可达十几层。

产业转移成就中国PCB产业大国，最重要的动力来源于成本和应用产业链两方面。在成本优势方面，中国在劳动力、土地、水电、资源和政策等方面具有巨大的优势；下游产业在中国的蓬勃发展，全球整机制造转移中国，提供了巨大的市场需求空间。中国由于下游产业的集中及劳动力、土地成本相对较低，成为发展势头最为强劲的区域。

2001年我国PCB行业总产值为360亿元，到2008年已经达到1183亿元，但是紧随其后的国际金融危机给全球PCB行业带来不小的震动，2009年全球PCB行业整体衰退程度达到16%，同样国内PCB行业也受到不小的冲击。2009年国内的家电下乡、3G拉动在一定程度上缓解了电子行业的压力，国内PCB行业总产值整体维持在千亿元以上。2009年，产值过10亿元的PCB企业为23家，总产值达到445亿元，占2009年国内PCB总产值近四成。

中国印制电路板业在内销增长和全球产能持续转移的形势下，将步入高速成长期。中国印制电路板的产业规模占全球比重到2014年将提高到41.92%。我国各类电子产品和LED等的兴起都对印制电路板行业产生强大的推动作用，未来五年中国印制电路板行业仍将保持快速增长。

。

报告目录

第一章 印制电路板（PCB）的相关概述

第一节 PCB的介绍

- 一、PCB的定义
- 二、PCB的分类
- 三、PCB的历史

第二节 PCB的产业链

- 一、PCB产业链的构成
- 二、产业链中的产品介绍

第二章 国际PCB产业发展分析

第一节 全球PCB产业发展概况

- 一、国际重点PCB制造企业发展概述
- 二、2012年全球PCB工业发展分析

- 三、2013年全球PCB行业发展分析
- 四、2013年全球PCB产业的格局变化
- 五、2013年国际柔性电路板行业的发展
- 六、国外印制电路板制造技术的发展
- 七、2013年全球PCB行业发展分析及预测

第二节 美国

- 一、美国PCB产业的发展概况
- 二、美国PCB主要生产厂家的发展
- 三、2013年北美印刷电路板发展现状

第三节 欧洲

- 一、欧洲PCB产业发展概况
- 二、2013年德国PCB产业的发展
- 三、2013年欧洲PCB行业发展分析

第四节 日本

- 一、日本PCB产业的发展阶段
- 二、日本PCB产业的发展回顾
- 三、2013年日本PCB产业的发展
- 四、日本领先PCB厂商发展高端路线

第五节 台湾地区

- 一、2012年台湾PCB产业的发展
- 二、2013年台湾PCB产业的发展
- 三、台湾PCB企业在大陆市场的发展动态

第三章 中国PCB产业发展分析

第一节 我国PCB产业的发展概况

- 一、我国PCB产业的产值及产能
- 二、我国PCB产业的产品结构
- 三、我国PCB行业配套日渐完善
- 四、2013年我国PCB行业的发展
- 五、2013年我国PCB产业的发展机遇

第二节 PCB产业竞争力分析

- 一、竞争对手
- 二、替代品

- 三、潜在进入者
- 四、供应商的力量

第三节 HDI市场发展分析

- 一、HDI市场容量
- 二、HDI市场供求
- 三、HDI市场趋势

第四节 我国PCB产业发展问题及对策

- 一、我国PCB产业与国外存在的差距
- 二、PCB产业发展面临的挑战
- 三、PCB产业持续发展的措施
- 四、PCB产业需发展民族品牌

第四章 PCB制造技术的研究

第一节 PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述

- 一、PCB芯片封装的介绍
- 二、PCB芯片封装的主要焊接方法
- 三、PCB芯片封装的流程

第二节 光电PCB技术

- 一、光电PCB的概述
- 二、光电PCB的光互连结构原理
- 三、光学PCB的优点
- 四、光电PCB的发展阶段

第三节 PCB技术的发展趋势

- 一、向高密度互连技术方向发展
- 二、组件埋嵌技术的发展
- 三、材料开发的提升
- 四、光电PCB的前景广阔
- 五、先进设备的引入

第五章 PCB上游原材料市场分析

第一节 铜箔

- 一、铜箔的相关概述
- 二、铜箔在柔性印制电路中的应用
- 三、电解铜箔产业的发展概况

第二节 环氧树脂

- 一、环氧树脂的相关概述
- 二、环氧树脂的主要应用领域
- 三、我国环氧树脂产业的发展现状

第三节 玻璃纤维

- 一、玻璃纤维的相关概述
- 二、我国成为全球最大玻璃纤维生产国
- 三、2013年我国玻璃纤维行业经济运行情况
- 四、2013年玻璃纤维产业的发展情况

第六章 PCB下游应用领域分析

第一节 消费类电子产品

- 一、2013年我国消费电子产品走向高端
- 二、消费电子用PCB市场需求稳定增长
- 三、高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热

第二节 通讯设备

- 一、2013年我国通讯设备制造业发展情况
- 二、2013年我国通信设备业的发展
- 三、语音通讯移动终端用PCB的发展趋势

第三节 汽车电子

- 一、PCB成为汽车电子市场的热点
- 二、多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大
- 三、2013年全球汽车电子PCB市场发展预测

第四节 LED照明

- 一、2013年中国LED照明的发展状况
- 二、LED发展为PCB行业带来新需求

第七章 国外重点PCB制造商介绍

第一节 日本企业

- 一、日本揖斐电株式会社(IBIDEN)
- 二、日本旗胜 (Nippon Mektron)
- 三、日本CMK公司

第二节 美国企业

- 一、MULTEK

- 二、美国TTM
- 三、新美亚 (SANMINA-SCI)
- 四、惠亚集团 (Viasystems)

第三节 韩国企业

- 一、三星电机 (Samsung E-M)
- 二、永丰 (Young Poong Group)
- 三、LG Electronics

第四节 台湾企业

- 一、欣兴电子
- 二、健鼎科技
- 三、雅新电子

第八章 国内PCB上市公司介绍

第一节 沪电股份

- 一、公司简介
- 二、2012年沪电股份经营状况分析
- 三、2013年沪电股份经营状况分析

第二节 天津普林

- 一、公司简介
- 二、2012年天津普林经营状况分析
- 三、2013年天津普林经营状况分析

第三节 生益科技

- 一、公司简介
- 二、2012年生益科技经营状况分析
- 三、2013年生益科技经营状况分析

第四节 超声电子

- 一、公司简介
- 二、2012年超声电子经营状况分析
- 三、2013年超声电子经营状况分析

第五节 超华科技

- 一、公司简介
- 二、2012年超华科技经营状况分析
- 三、2013年超华科技经营状况分析

第六节 上市公司财务比较分析

- 一、盈利能力分析
- 二、成长能力分析
- 三、营运能力分析
- 四、偿债能力分析

第九章 2014-2020年PCB行业投资分析及前景预测

第一节 2014-2020年PCB投资分析

- 一、PCB行业SWOT分析
- 二、PCB投资面临的风险
- 三、PCB市场投资空间大

第二节 2014-2020年PCB产业发展前景预测

- 一、2013年PCB产业的发展前景
- 二、2013年软板与HDI板发展前景向好
- 三、2014-2020年我国印制电路板产业的发展前景预测
- 四、未来我国PCB行业将保持高速增长
- 五、十二五期间我国PCB产业的发展重点

图表目录

图表：各国家/地区PCB工厂数目

图表：2012年全球不同种类PCB的增长率（按产品类型分）

图表：2012年电子整机及PCB的应用领域和未来发展

图表：2012年全球各国PCB产值

图表：2012年电子工业（半导体）和PCB工业的增长

图表：2013年全球各地区PCB产值分布

图表：2013年全球主要手机PCB板厂家市场占有率

图表：2000年和2013年全球PCB下游应用比例

图表：2000年和2013年全球PCB产品结构

图表：美国PCB产值变化情况

图表：日本PCB产量统计表

图表：日本PCB厂家海外产值（按产品类型分类）

图表：日本PCB厂家海外产值（按国家分类）

图表：日本PCB进出口量（按国别统计）

图表：日本PCB出口量（按地区统计）

图表：2010-2013年日本印刷电路板设备投资额

图表：2012年台湾PCB的资本构成

图表：2012年台湾不同种类PCB的比例

图表：台湾PCB市场规模

图表：2013年中国PCB产业主要本土企业销售收入增长幅度

图表：光学PCB和传统PCB的优点对比

图表：压延退火方法制造的铜箔产品

图表：铜箔的分类

图表：电解铜箔制造过程示意图

图表：铜箔的处理阶段和稳定性

图表：环氧树脂胶粘剂的主要用途

图表：2012-2013年华东环氧树脂市场走势图

图表：2007-2013年华东环氧树脂市场走势图

图表：2013年全国玻璃纤维纱累计产量

图表：2013年玻纤及制品主要进口来源地

图表：2012年7月-2013年9月玻璃纤维及制品当月出口量

图表：2013年通信设备制造业工业销售情况

图表：2013年我国通信设备产品产量及增长

图表：2013年我国通讯设备主要出口产品增长情况

图表：2013年我国通讯设备主要进口产品增长情况

图表：2013年通信设备制造业、计算机及其他电子设备制造业投资情况

图表：2013年通信设备制造业不同所有制企业经营情况

图表：2013年通信设备制造业不同规模企业经营情况

图表：全球手机销售量与Smart Phone市场渗透率

图表：2013年国内LED产量、芯片产量及芯片国产率

图表：2003-2013年我国LED市场规模及增长率变化

图表：2003-2013年我国LED封装产量变化

图表：2013年我国半导体照明应用领域

图表：2013年9月国内外功率型白光LED技术指标对比

图表：2013年沪电股份主营构成表

图表：2010-2013年沪电股份流动资产表

图表：2010-2013年沪电股份长期投资表

图表：2010-2013年沪电股份固定资产表
图表：2010-2013年沪电股份无形及其他资产表
图表：2010-2013年沪电股份流动负债表
图表：2010-2013年沪电股份长期负债表
图表：2010-2013年沪电股份股东权益表
图表：2010-2013年沪电股份主营业务收入表
图表：2010-2013年沪电股份主营业务利润表
图表：2010-2013年沪电股份营业利润表
图表：2010-2013年沪电股份利润总额表
图表：2010-2013年沪电股份净利润表
图表：2010-2013年沪电股份每股指标表
图表：2010-2013年沪电股份获利能力表
图表：2010-2013年沪电股份经营能力表
图表：2010-2013年沪电股份偿债能力表
图表：2010-2013年沪电股份资本结构表
图表：2010-2013年沪电股份发展能力表
图表：2010-2013年沪电股份现金流量分析表
图表：2013年沪电股份非经常性损益项目及金额
图表：2013年天津普林主营构成表
图表：2010-2013年天津普林流动资产表
图表：2010-2013年天津普林长期投资表
图表：2010-2013年天津普林固定资产表
图表：2010-2013年天津普林无形及其他资产

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201408/110723.html>